

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230921

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	2023年9月20日：东方阿尔法基金：梁少文、唐雷；源乐晟资产：吴雨哲；天弘基金：张磊；高毅资产：张新和；鹏扬基金：叶文强；东方红资管：孙可；浙商基金：胡博清；国泰基金：饶玉涵；聚鸣投资：史书；APS资产：王兴林；泰康资产：邹志、王铎霖；中金公司：江磊等17名投资者及证券人员 2023年9月21日：佳银资本：王吉鹏；华创证券：熊翊宇、王帅、姚德昌；尚正基金：李睿；安信证券：程宇婷；招商信诺资管：刘泽宇；朱雀基金：赵晗泥；西部利得基金：侯文佳；国金证券：赵晋等11名投资者及证券人员
时间	2023年9月20日 14:00~15:00 2023年9月21日 13:30~16:00
地点	2023年9月20日：线上会议 2023年9月21日：公司905会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书杨平彩女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p><b>问 1：公司 CMP 抛光垫下半年销售情况如何？</b> 答：今年上半年度，受半导体行业下游应用端周期调整需求疲软影响所致，公司 CMP 抛光垫产品的销售收入同比下滑 37%，但二季度的销售收入环比一季度增长 33%，呈现了边际改善趋势。今年下半年，随着在逻辑晶圆厂客户端的市场开拓工作持续推进，以及在存储晶圆厂客户端销售的恢复，公司 CMP 抛光垫业务的经营状况会较上半年有所好转，单季度销售收入争取先恢复到去年的平均水平。</p> <p><b>问 2：公司 CMP 抛光液产品的技术来源情况？</b> 答：公司自研团队花了 2~3 年时间，实现了从 CMP 抛光液上游核心原材料-研磨粒子到 CMP 抛光液产品配方的自主研发，期间研发投入较大，项目进展的速度也比较快，现已多线布局了多晶硅制程、金属铜制程、金属铝</p>

制程、阻挡层制程、金属钨制程、介电层制程等数十款 CMP 抛光液产品，并有多款 CMP 抛光液产品在客户端销售。

**问 3：公司 CMP 抛光液项目进展较快的原因？**

答：CMP 抛光垫与 CMP 抛光液是在集成电路前段制程中的化学机械抛光（CMP）环节搭配使用的核心耗材。公司通过前期 CMP 抛光垫产品的自主研发并在客户端批量应用，对 CMP 抛光液产品具备了一定的应用理解。同时凭借公司技术平台的积累优势，将载体团队的无机非金属技术运用到 CMP 抛光液上游核心原料-研磨粒子的研发过程中，以较快速度推进研磨粒子的开发，运用自制研磨粒子同步助力 CMP 抛光液配方开发，从而加快了 CMP 抛光液项目的开发进程。

**问 4：公司 CMP 抛光液产品目前的市场策略？**

答：目前国内 CMP 抛光液市场有过半数的销售份额尚由海外厂商占据，公司通过 CMP 抛光液产品的多制程多型号布局，部分产品和海外厂商对标，在近两年持续大力开展在客户端的验证导入工作，争取不断增加在客户端销售的 CMP 抛光液产品的型号数量，夯实后续 CMP 抛光液业务持续放量的基础。

**问 5：公司预计今年下半年显示材料放量情况如何？**

答：今年上半年度，公司半导体显示材料产品实现销售收入 5,034 万元，同比增长 339%，且第二季度的销售收入环比第一季度大幅增长 185%，整体放量节奏较快。今年下半年，随着公司显示材料产品在下游面板客户端的持续导入、上量，公司显示材料业务有望在今年第三、第四季度保持增长趋势。

**问 6：公司显示材料在下游客户端的采购占比情况如何？**

答：目前公司已有 YPI、PSPI 两类显示材料产品在下游面板客户端批量销售，并已成为国内部分主流面板客户的 YPI、PSPI 材料的第一供应商。公司将持续推进市场开拓和产品导入工作，努力提升公司显示材料产品在客户端的采购占有率，争取在近两年成为更多主流面板客户的第一供应商。

**问 7：公司先进封装材料业务进展情况如何？**

答：目前公司先进封装材料产品中进展较快的是临时键合胶和封装光刻胶，其中临时键合胶产品预计在今年年内完成量产导入工作并获得首笔订单；封装光刻胶产品正在客户端验证中，截至目前客户验证反馈良好。

**问 8：公司仙桃产业园建设情况如何？潜江工厂运行情况如何？**

答：公司仙桃光电半导体材料产业园预计于今年第四季度全面竣工，开始试生产供应，为后期 PSPI、CMP 抛光液等产品的稳定放量奠定基础。公司潜江光电半导体材料产业园 CMP 抛光垫新品产线于去年下半年建成试生产，现阶段重点开展各抛光垫新品在各晶圆厂的验证、导入工作。

附件清单	无
日期	2023 年 9 月 21 日